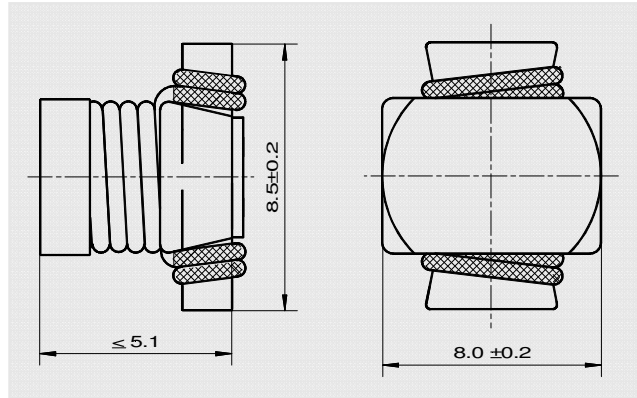


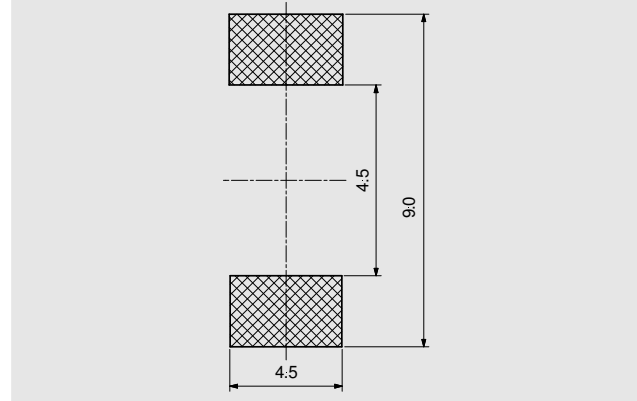
Series Ms 85T; Choke for ambient temperature up to 150°C

L [μH]	± %	R ≤ [Ω]	I _{max} [A]	f _{res} ≥ [MHz]	part number
4.7	30	0.032	3.6	20	88804446
10	25	0.05	3.0	17	88804450
12	25	0.06	2.7	16	88804451
15	25	0.07	2.5	15	88804452
18	25	0.1	2.4	14	88804453
22	20	0.11	2.1	13	88804454
27	20	0.12	1.8	12	88804455
33	20	0.15	1.6	11	88804456
39	20	0.18	1.5	10	88804457
47	20	0.2	1.4	9	88804458
56	20	0.56	1.2	8	88804459
68	20	0.28	1.0	7	88804460
82	20	0.35	0.9	6.5	88804461
100	20	0.43	0.85	5.5	00611972
120	20	0.5	0.79	5	88804463
150	20	0.6	0.7	4.5	88804464
180	20	0.75	0.65	4	88804465
220	20	1.0	0.62	3.5	88804466
270	20	1.1	0.6	3.2	88804467
330	20	1.35	0.57	2.8	88804468
390	15	1.6	0.51	2.3	88804469
470	15	2.0	0.44	1.8	88804470
560	15	2.4	0.42	1.7	88804471
680	15	2.7	0.39	1.6	88804472
820	15	3.2	0.36	1.4	88804473
1000	15	4.3	0.32	1.2	88804474
1200	15	4.6	0.29	1.0	88804475
1500	15	6.5	0.26	0.85	88804476
1800	15	7.0	0.24	0.7	88804477
2200	15	9.2	0.22	0.55	88804478
2700	15	10.5	0.2	0.4	88804479
3300	15	15.0	0.18	0.35	88804480
4700	15	19.0	0.16	0.3	88804481
5600	15	24.0	0.14	0.25	88804482
6800	15	26.0	0.13	0.2	88804483

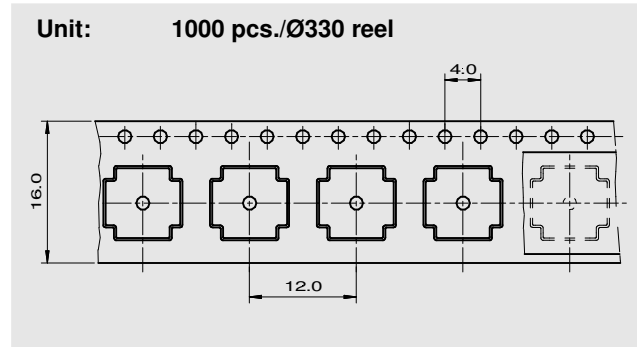
Dimensions and footprint (mm)



Solder areas - Recommendation



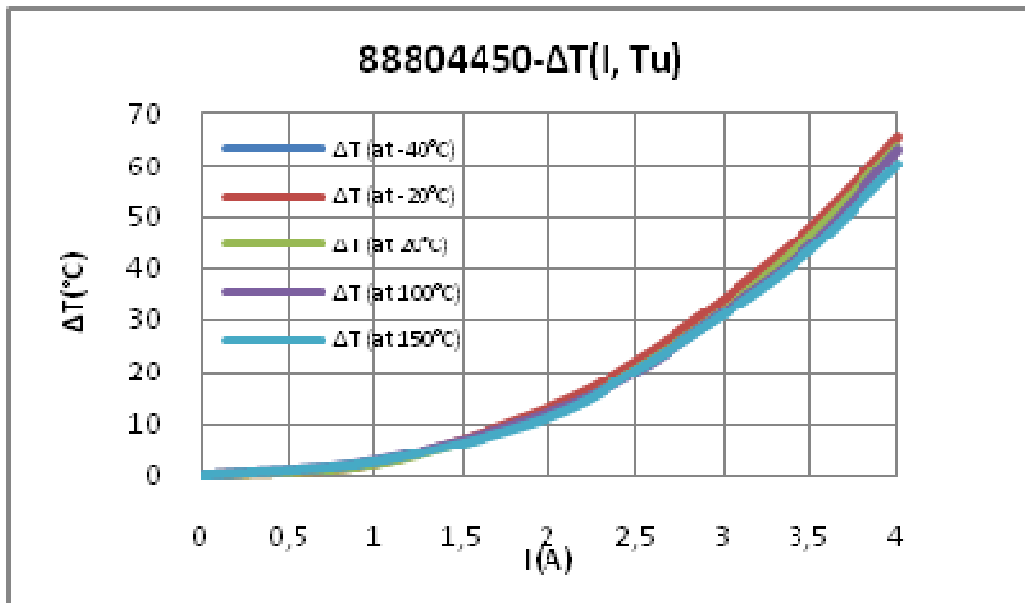
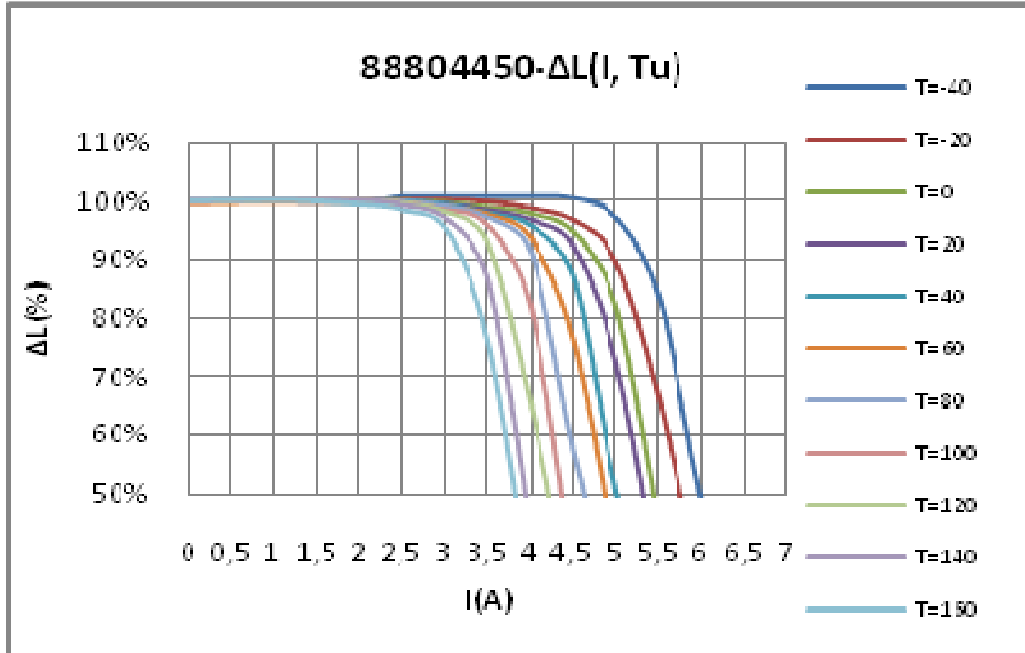
Packaging: Tape & reel



I_{max}: ΔL app. 10%; θ_ü ≤ 40°C. Other types on request.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.

Example of measurement: Ms 95T/330 μ H



Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. No responsibility is taken for the correctness. Errors and changings reserved.

Einstück-Entwicklung SMD Induktivitäten

Lassen Sie die anderen kleben!

Das Kleben des Spulenkörpers auf eine Grundplatte ersparen wir uns. Stattdessen fertigen wir beide Teile in einem Stück.

Der Vorteil zeigt sich klar auf der Leiterplatte

Die kompakte Bauform dieser Reihe von Festinduktivitäten braucht ein Minimum an Platz. Ein weiteres Plus ist das Streufeld.

Auf lästige Fehlerquellen bei der Kontaktierung und an den Klebestellen verzichten wir dabei. Überflüssig sind dadurch auch die sonst üblichen metallclips, Metallisierungen oder Lötpins. Die Wickelenden der Spulendrähte werden dann noch verzinkt und bilden so gleichzeitig die Lötstellen. Damit bringen wir sie auf die Platine. Das war dann eigentlich schon alles.

Kennzeichen

- ✓ Kompakte Bauform
- ✓ Hohe Strombelastbarkeit
- ✓ Hohe Temperatur- und Schwingungsfestigkeit unter „Heavy-Duty“ Bedingungen
- ✓ AEC-Q200 Qualifikation
- ✓ Geringer Gleichstromwiderstand
- ✓ Automatisch bestückbar
- ✓ Für Reflow- und Dampfphasenlötung

Anwendungen

- ✓ Funkentstörung
- ✓ DC/DC Wandler
- ✓ AC/DC Wandler
- ✓ Entkopplung in HF- und ZF-Schaltungen
- ✓ Sicherheitssysteme in der KFZ Elektronik

One-piece – developments SMD inductors

Who needs glue?

We don't bother with gluing bobbins onto base plates any more. Instead, we fabricate both parts in one piece, as ferrite components.

The benefits are clear to see on any PCB

The compact design of this series of fixed inductors means they only require a minimum space

Using this method, we avoid troublesome sources of fault during bonding and at the gluing points. And the otherwise ubiquitous metal clips, soldering pins or plating are likewise all superfluous. The lead-out wires of the coil windings are then tinned and so simultaneously act as the soldering points. This is how we mount them on the circuit board. And that's all there is to it!

Features

- ✓ Compact design
- ✓ High current-load capacity
- ✓ High vibration and temperatures resistance under "Heavy Duty" conditions
- ✓ AEC-Q200 qualification
- ✓ Low DC resistance
- ✓ Suitable for automatic insertion
- ✓ For reflow and vapor phase soldering

Applications

- ✓ Radio interference suppression
- ✓ DC/DC- Power supply
- ✓ AC/DC Power supply
- ✓ Decoupling in RF-circuits
- ✓ Safety devices in automotive electronics

